

ハードウェアセキュリティフォーラム2018 【参加募集】

【概要】

日時：平成30年12月13日（木）10:00-17:00（開場・受付開始 9:30）

会場：東京大学・武田先端知ビル 武田ホール

東京都文京区弥生2-11-16

最寄り駅：東京メトロ千代田線 根津駅（C14）

会場案内図：<http://www.vdec.u-tokyo.ac.jp/Guide/access.html>

主催：（社）電子情報通信学会・ハードウェアセキュリティ研究専門委員会(HWS)

協賛：（社）電子情報通信学会・集積回路研究会(ICD)

参加費：4000円（当日受付にてお支払い下さい。領収書発行可）

【実行委員】

島崎靖久（ルネサス）（委員長），栗野皓光（東大），大和田徹（ITS-TEA），
国井裕樹（セコム），佐伯稔（IPA），近田恭之（DNP）

【プログラム構成(予定)】

口頭発表 10:00-12:00

ハードウェアセキュリティ研究会若手優秀賞表彰式 13:30-13:50

口頭発表（続き） 13:50-15:30

ポスターセッション 15:40-17:00

プログラム：http://www.ieice.org/ess/hws/meeting/workshop/HWS_Forum_Program_2018.pdf

（ポスターセッションに引き続いて懇親会を開催。参加費1000円程度。領収書発行可）

ハードウェアセキュリティ分野における最新の研究動向・研究成果に関する口頭発表
およびポスター発表を募集いたします。

【発表申し込み】

※ご発表申込は下記のWebサイトからお願いいたします。

[発表申込〆切：2018年11月16日(金)23:59まで 2018年11月30日(金)23:59まで 締め切りました]

<http://www.ieice.org/ken/program/index.php?tqid=IEICE-HWS>

題目，著者，所属，アブストラクト(100字程度，プログラムに公開予定)

講演種別(口頭orポスター)の希望

他の国際学会等で既発表の内容の場合，その情報もご連絡下さい。

※発表申込多数の場合は，受付順に開催主催者にて選定いたします。

【参加申し込み】

以下のフォームからWebで入力いただくか，下記フォーマットに従ってメールにて申し込みく

ださい.

[参加申込〆切：2018年12月10日(月)12:00まで 2018年12月12日(水)23:59まで<当日参加も可>]

<Web>

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuro-pLNFkHi2oersawo2fOWjchwxWk6DSQtpsVqWWuD_S5w/viewform?vc=0&c=0&w=1&usp=mail_form_link

<メール>

宛先：hws-forum18@mail.ieice.org

件名：HWSフォーラム2018参加申し込み

本文：

お名前：

ご所属：

懇親会の参加有無：

参加費領収書有無：（有りの場合は宛名もご指定をお願いいたします）

懇親会領収書有無：（有りの場合は宛名もご指定をお願いいたします）

以上